2024.10.11

아주대학교

미래반도체 연계/마이크로전공

참여학생 모집 설명회

반도체특성화대학사업단

아주대학교

CONTENTS

01 사업단 소개

- BeSPoKe 반도체 인재양성 비전
- 참여교원 현황
- 교육 인프라

02 미래반도체 연계/마이크로 전공

- 미래반도체 연계전공
- 미래반도체 마이크로전공

03 수혜학생 혜택 및 신청방법

- 수혜학생 혜택
- 연계전공/마이크로전공 신청방법

Copyright © Mangoboard All Rights Reserved.

01

반도체특성화사업단

사업단 소개

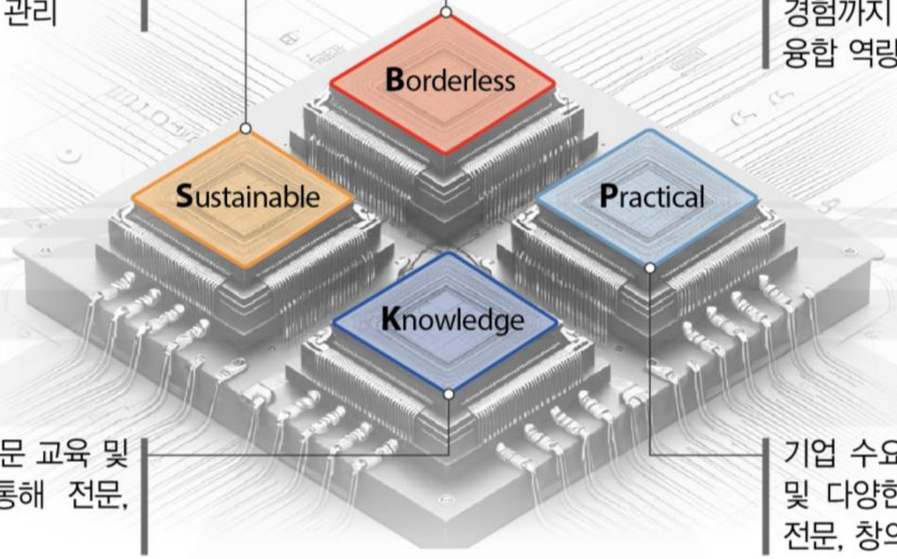
BeSPoke 반도체 인재양성 비전

사업단 비전	미래 가치 창출을 선도하는 국가 반도체 크로스 보더 에듀 클러스터 구축
사업단 목표	경기–충청 K–반도체 밸류체인의 지속 성장을 위한 비스포크(Bespoke) 반도체 전문인재 양성
핵심역량	전문 역량 + 창의 역량 + 융합 역량 + 글로벌 역량 + 문제해결 역량

BeSPoKe 추진전략

지속 가능한 수도권–충청권 산학협력 교육 체계 구축 및 배출인력 관리

대학 및 학문간 경계를 넘어 교실 밖 경험까지 아우르는 교육을 통해 창의, 융합 역량 강화



사례 중심 단계별 반도체 전문 교육 및 글로벌 연계 프로그램을 통해 전문, 글로벌, 문제해결 역량 강화

기업 수요 기반 실무형 교육과정 운영 및 다양한 취·창업 지원 교육을 통해 전문, 창의, 문제해결 역량 강화

BeSPoke 반도체 인재양성 비전

BeSPoKe 반도체 인력양성 사업단

아주대학교

반도체 회로 및 소자공정 특성화

- Bespoke 회로 설계 교육
- 반도체 소자 공정 교육
- 설계 전용 실습실 및 전문 CAD 툴 보유 (Synopsys, Cadence)
- Si CMOS 교육용 클린룸

Key 교류 방안

- 교육 노하우 상호 이전
- 공동학위제 운영
- JA교원 상호파견
- 코티칭 교과목 확대

국립한밭대학교

반도체 시스템 및 패키징 특성화

- Bespoke 시스템 설계 교육
- 반도체 패키지 공정 교육
- 반도체 회로 시스템 전용 실습실 보유
- Micro Interconnection 공정 장비 및 CMP 등 인프라 보유

반도체 인력양성 사업 전

- CMOS 공정교육
- SoC 설계교육
- FPGA 전문교육
- 패키징 교육

BeSPoKe 반도체 인력양성 사업단

- IC 설계 PBL 교육 노하우
  반도체 공정 교육 노하우
  테스팅 교육 프로그램 신설
- FPGA 설계 PBL 교육 노하우
  패키징 교육 프로그램

반도체 인력양성 사업 후

- 3D IC 교육
- Bespoke 반도체 설계 교육
- 첨단 패키징 교육

참여교원 현황

반도체특성화대학사업단

- 아주대학교
- 한밭대학교

지능형반도체공학과	전자공학과	첨단신소재공학과	물리학과	화학공학과	AI모빌리티공학과 (미래모빌리티공학과)
5명	8명	4명	5명	1명	(신설학과)

교육 인프라

Si 반도체 교육 전용 클린룸

종합반도체 클린룸

교육 인프라 공유 및 확대

1 Silicon CMOS Clean room / Device Testing area

아주대학교 토목실험동
클린룸 실습환경 개선

CMOS 노후장비 개선
실습용 신규장비 구축

실습공유공간 103.9m²
신규구축

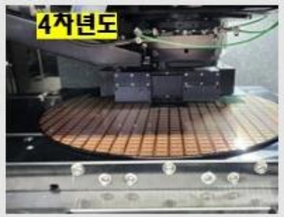
CMOS 공정 Si 반도체
테스팅 장비 확보

2 Advanced Device Packaging

한밭대학교 공정실습실
클린룸 실습환경 개선

반도체 패키징
공유실습실 환경 개선

반도체 공정 노후장비
개선 및 신규장비 구축

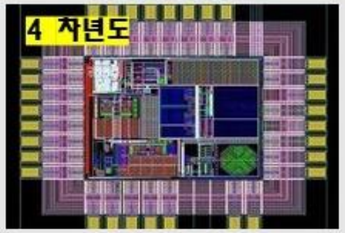


첨단 패키징 공정
실습 환경 구축

3 BESPOKE Chip Design

아주대학교 회로설계실습실
실습환경 개선

시뮬레이션 서버 확장
서버룸 구축



설계 소프트웨어
라이브러리 구축 및 조성

4 BESPOKE System Design

한밭대학교 시스템 설계
실습실 환경개선

RF 시스템설계 노후장비
개선 및 신규장비 구축

SoC 및 FPGA 시스템 설계
실습 환경 고도화

아주대학교

02

반도체특성화사업단

미래반도체 연계/마이크로 전공

미래반도체 연계전공

“ ”

마이크로전공 2개 이상 이수

미래반도체 연계전공 복수전공 36학점 이상, 부전공 21학점 이상 이수

- 미래반도체 기초
- 미래반도체 핵심
- 미래반도체 심화
- 미래반도체 심화 캡스톤
- 미래반도체 응용

이수요건	복수전공 : 36학점 이상의 전공과목을 이수 부전공 : 21학점 이상의 전공과목을 이수 마이크로전공 : 해당 전공 교과목 중 9학점 이상 이수

미래 반도체 연계전공 과목

기초	핵심	심화		응용	
미래반도체입문	반도체공학2	반도체재료및물성	RF회로	신호및시스템	통신시스템
인공지능기초실습	반도체공정기술	나노스케일실리콘소자	지능형반도체설계	자동제어	전동기제어
융합프로그래밍	반도체실험	센서공학	센서인터페이스설계	인공지능수학	광반도체공학
반도체물리	전자회로2	반도체소자평가	VLSI시스템설계	디스플레이공학	임베디드시스템실험
전자기학	아날로그집적회로	메모리설계	시스템반도체설계	임베디드시스템설계	딥러닝시스템
반도체공학1	디지털집적회로	반도체공정장비실습	반도체테스팅	컴퓨터구조	디지털신호처리
전자회로		나노및마이크로소자공정		머신러닝기초	전력전자공학
확률및랜덤변수		뉴로모픽소자설계			
회로이론		반도체집적공정설계			
논리회로		3D반도체설계			

반도체연구 (캡스톤1)	반도체심화연구1 (캡스톤2)	반도체심화연구2 (캡스톤3)
심화 캡스톤		

공통기초	소자·공정 · 패키징	회로 · 시스템	응용

미래 반도체 연계전공 과목

기초	핵심	심화		응용	
미래반도체입문	반도체공학2	반도체재료및물성	RF회로	신호및시스템	통신시스템
인공지능기초실습	반도체공정기술	나노스케일실리콘소자	지능형반도체설계	자동제어	전동기제어
융합프로그래밍	반도체실험	센서공학	센서인터페이스설계	인공지능수학	광반도체공학
반도체물리	전자회로2	반도체소자평가	VLSI시스템설계	디스플레이공학	임베디드시스템실험

마이크로전공 2개 (9학점+9학점) + 3학점 이수
= 미래반도체 연계전공 부전공 가능

반도체연구 (캡스톤1)	반도체심화연구1 (캡스톤2)	반도체심화연구2 (캡스톤3)
심화 캡스톤		

공통기초	소자·공정 · 패키징	회로 · 시스템	응용

미래 반도체 연계전공 과목

기초	핵심	심화		응용	
미래반도체입문	반도체공학2	반도체재료및물성	RF회로	신호및시스템	통신시스템
인공지능기초실습	반도체공정기술	나노스케일실리콘소자	지능형반도체설계	자동제어	전동기제어
융합프로그래밍	반도체실험	센서공학	센서인터페이스설계	인공지능수학	광반도체공학
반도체물리	전자회로2	반도체소자평가	VLSI시스템설계	디스플레이공학	임베디드시스템실험
전자기학	아날로그집적회로	메모리설계	시스템반도체설계	임베디드시스템설계	딥러닝시스템
반도체공학1	디지털집적회로	반도체공정장비실습	반도체테스팅	컴퓨터구조	디지털신호처리
전자회로		나노및마이크로소자공정		머신러닝기초	전력전자공학
확률및랜덤변수		뉴로모픽소자설계			
회로이론		반도체집적공정설계			
논리회로		3D반도체설계			

반도체연구 (캡스톤1)	반도체심화연구1 (캡스톤2)	반도체심화연구2 (캡스톤3)
심화 캡스톤		

공통기초	소자·공정 · 패키징	회로 · 시스템	응용

미래 반도체 연계전공 과목

기초	핵심	심화		응용	
미래반도체입문	반도체공학2	반도체재료및물성	RF회로	신호및시스템	통신시스템
인공지능기초실습	반도체공정기술	나노스케일실리콘소자	지능형반도체설계	자동제어	전동기제어
융합프로그래밍	반도체실험	센서공학	센서인터페이스설계	인공지능수학	광반도체공학
반도체물리	전자회로2	반도체소자평가	VLSI시스템설계	디스플레이공학	임베디드시스템실험
전자기학	아날로그집적회로	메모리설계	시스템반도체설계	임베디드시스템설계	딥러닝시스템
반도체공학1	디지털집적회로	반도체공정장비실습	반도체테스팅	컴퓨터구조	디지털신호처리
전자회로		나노및마이크로소자공정		머신러닝기초	전력전자공학
확률및랜덤변수		뉴로모픽소자설계			
회로이론		반도체집적공정설계			
논리회로		3D반도체설계			

반도체연구 (캡스톤1)	반도체심화연구1 (캡스톤2)	반도체심화연구2 (캡스톤3)
심화 캡스톤		

공통기초	소자·공정 · 패키징	회로 · 시스템	응용

미래 반도체 연계전공 과목

기초	핵심	심화		응용	
미래반도체입문	반도체공학2	반도체재료및물성	RF회로	신호및시스템	통신시스템
인공지능기초실습	반도체공정기술	나노스케일실리콘소자	지능형반도체설계	자동제어	전동기제어
융합프로그래밍	반도체실험	센서공학	센서인터페이스설계	인공지능수학	광반도체공학
반도체물리	전자회로2	반도체소자평가	VLSI시스템설계	디스플레이공학	임베디드시스템실험
전자기학	아날로그집적회로	메모리설계	시스템반도체설계	임베디드시스템설계	딥러닝시스템
반도체공학1	디지털집적회로	반도체공정장비실습	반도체테스팅	컴퓨터구조	디지털신호처리
전자회로		나노및마이크로소자공정		머신러닝기초	전력전자공학
확률및랜덤변수		뉴로모픽소자설계			
회로이론		반도체집적공정설계			
논리회로		3D반도체설계			

반도체연구 (캡스톤1)	반도체심화연구1 (캡스톤2)	반도체심화연구2 (캡스톤3)
심화 캡스톤		

공통기초	소자·공정 · 패키징	회로 · 시스템	응용

미래 반도체 연계전공 과목

기초	핵심	심화		응용	
미래반도체입문	반도체공학2	반도체재료및물성	RF회로	신호및시스템	통신시스템
인공지능기초실습	반도체공정기술	나노스케일실리콘소자	지능형반도체설계	자동제어	전동기제어
융합프로그래밍	반도체실험	센서공학	센서인터페이스설계	인공지능수학	광반도체공학
반도체물리	전자회로2	반도체소자평가	VLSI시스템설계	디스플레이공학	임베디드시스템실험
전자기학	아날로그집적회로	메모리설계	시스템반도체설계	임베디드시스템설계	딥러닝시스템
반도체공학1	디지털집적회로	반도체공정장비실습	반도체테스팅	컴퓨터구조	디지털신호처리
전자회로		나노및마이크로소자공정		머신러닝기초	전력전자공학
확률및랜덤변수		뉴로모픽소자설계			
회로이론		반도체집적공정설계			
논리회로		3D반도체설계			

반도체연구 (캡스톤1)	반도체심화연구1 (캡스톤2)	반도체심화연구2 (캡스톤3)
심화 캡스톤		

공통기초	소자·공정 · 패키징	회로 · 시스템	응용

미래 반도체 연계전공 과목

기초	핵심	심화		응용	
미래반도체입문	반도체공학2	반도체재료및물성	RF회로	신호및시스템	통신시스템
인공지능기초실습	반도체공정기술	나노스케일실리콘소자	지능형반도체설계	자동제어	전동기제어
융합프로그래밍	반도체실험	센서공학	센서인터페이스설계	인공지능수학	광반도체공학
반도체물리	전자회로2	반도체소자평가	VLSI시스템설계	디스플레이공학	임베디드시스템실험
전자기학	아날로그집적회로	메모리설계	시스템반도체설계	임베디드시스템설계	딥러닝시스템
반도체공학1	디지털집적회로	반도체공정장비실습	반도체테스팅	컴퓨터구조	디지털신호처리
전자회로		나노및마이크로소자공정		머신러닝기초	전력전자공학
확률및랜덤변수		뉴로모픽소자설계			
회로이론		반도체집적공정설계			
논리회로		3D반도체설계			

반도체연구 (캡스톤1)	반도체심화연구1 (캡스톤2)	반도체심화연구2 (캡스톤3)
심화 캡스톤		

공통기초	소자·공정 · 패키징	회로 · 시스템	응용

마이크로전공 과목

기초

교과목	비고
미래반도체입문(공동)	전공입문
반도체물리, 전자기학, 반도체공학1	소자공정패키징
회로이론, 논리회로, 전자회로	회로시스템
인공지능기초실습, 융합프로그래밍, 확률및랜덤변수	인공지능응용기초

핵심

교과목	비고
반도체공학2, 반도체실험, 반도체공정기술	소자공정패키징
전자회로2, 아날로그집적회로, 디지털집적회로	회로시스템

심화

교과목	비고
나노및마이크로소자공정, 나노스케일실리콘소자, 반도체소자평가, 반도체재료및물성, 뉴로모픽소자설계, 메모리설계, 센서공학, 반도체공정장비실습, 반도체집적공적설계, 3D반도체설계	소자공정패키징
VLSI시스템설계, 시스템반도체설계, 센서인터페이스설계, RF회로, 지능형반도체설계, 반도체테스팅	회로시스템

심화 캡스톤

교과목	비고
반도체연구, 반도체심화연구1, 반도체심화연구2	캡스톤주제별 지정심화 1과목 필수

응용

교과목	비고
자동제어, 전동기제어, 전력전자공학	모빌리티반도체응용
임베디드시스템설계, 임베디드시스템실험, 컴퓨터구조	반도체시스템응용
신호및시스템, 디지털신호처리, 통신시스템	통신반도체응용
디스플레이공학, 광반도체공학	디스플레이응용
인공지능수학, 머신러닝기초, 딥러닝시스템	인공지능응용

미래 반도체 마이크로전공 단계

기초

- 입문자 맞춤형
- 반도체입문/기초교육 과정 제공

핵심

- 전공자 맞춤형
- 반도체 핵심역량 개발
- 소자공정· 패키징/ 회로 ·시스템 핵심교육과정 제공

심화/응용

- 전문분야 맞춤형
- 산업체연계 실무형 심화교육
- 인공지능/응용분야별 융합형 인재 양성

심화캡스톤

- 경력개발 맞춤형
- 장기프로젝트 중심의 특성화 교육체계구축
- 산업체 수요 연계 캡스톤 운영
- 학-석연계형 캡스톤 운영

PBL운영지식 공유 및 상호전수

미래 반도체 마이크로전공 예시 (전자공학과 3학년2학기)

년도/학기	과목명	학점	년도/학기	과목명	학점
<전문교양>			2024-1학기	전자회로실험(설계:1)	2
2020-1학기	영어2	3	2024-2학기	융합캡스톤디자인1(설계:2)	2
2020-2학기	영어1(E)	3	<전공인선>		
2023-1학기	글쓰기	3	2024-1학기	디지털시스템설계(E)	3
2023-동계계절	과학기술과 법	3	2024-1학기	자동제어	3
<수학>			2024-1학기	확률 및 랜덤변수	3
2020-1학기	수학1	3	2024-2학기	디지털집적회로(설계:1)	3
2020-2학기	공업수학A	3	2024-2학기	반도체공학2	3
2020-2학기	수학2	3	2024-2학기	반도체실험(설계:1)	3
2023-1학기	공업수학G	3	2024-2학기	아날로그집적회로(설계:1)	3
<기초과학>			<교양선택>		
2020-1학기	물리학1	3	2020-1학기	아주희망	1
2020-1학기	물리학실험1	1	2023-1학기	아주인성	1
2020-1학기	화학	3	2024-2학기	여대생 커리어개발2	1
2020-1학기	화학실험	1			
2020-2학기	물리학2	3			
2020-2학기	물리학실험2	1			
2023-2학기	현대물리학	3			
<전산학>					
2020-1학기	융합프로그래밍	4			
<전공인필>					
2020-2학기	어드벤처디자인(설계:3)	3			
2023-1학기	기초전기실험	2			
2023-1학기	논리회로	3			
2023-1학기	전자기학	3			
2023-1학기	회로이론	3			
2023-2학기	4차 산업혁명 Connecting Minds	1			
2023-2학기	논리회로실험(설계:0.5)	2			
2023-2학기	신호 및 시스템	3			
2023-2학기	자료구조및알고리즘이해	3			
2023-2학기	전자장론	3			
2023-2학기	전자회로1	3			
2024-1학기	반도체공학1	3			
2024-1학기	전자회로2	3			

미래반도체 기초 마이크로전공 이수가능

- 융합프로그래밍
- 논리회로
- 전자기학
- 회로이론
- 반도체공학1
- 확률 및 랜덤변수

미래 반도체 마이크로전공 예시 (전자공학과 3학년2학기)

년도/학기	과목명	학점	년도/학기	과목명	학점
<전문교양>			2024-1학기	전자회로실험(설계:1)	2
2020-1학기	영어2	3	2024-2학기	융합캡스톤디자인1(설계:2)	2
2020-2학기	영어1(E)	3	<전공인선>		
2023-1학기	글쓰기	3	2024-1학기	디지털시스템설계(E)	3
2023-동계계절	과학기술과 법	3	2024-1학기	자동제어	3
<수학>			2024-1학기	확률 및 랜덤변수	3
2020-1학기	수학1	3	2024-2학기	디지털집적회로(설계:1)	3
2020-2학기	공업수학A	3	2024-2학기	반도체공학2	3
2020-2학기	수학2	3	2024-2학기	반도체실험(설계:1)	3
2023-1학기	공업수학G	3	2024-2학기	아날로그집적회로(설계:1)	3
<기초과학>			<교양선택>		
2020-1학기	물리학1	3	2020-1학기	아주희망	1
2020-1학기	물리학실험1	1	2023-1학기	아주인생	1
2020-1학기	화학	3	2024-2학기	여대생 커리어개발2	1
2020-1학기	화학실험	1			
2020-2학기	물리학2	3			
2020-2학기	물리학실험2	1			
2023-2학기	현대물리학	3			
<전산학>					
2020-1학기	융합프로그래밍	4			
<전공인필>					
2020-2학기	어드벤처디자인(설계:3)	3			
2023-1학기	기초전기실험	2			
2023-1학기	논리회로	3			
2023-1학기	전자기학	3			
2023-1학기	회로이론	3			
2023-2학기	4차 산업혁명 Connecting Minds	1			
2023-2학기	논리회로실험(설계:0.5)	2			
2023-2학기	신호 및 시스템	3			
2023-2학기	자료구조및알고리즘이해	3			
2023-2학기	전자장론	3			
2023-2학기	전자회로1	3			
2024-1학기	반도체공학1	3			
2024-1학기	전자회로2	3			

미래반도체 기초 마이크로전공 이수가능

- 융합프로그래밍
- 논리회로
- 전자기학
- 회로이론
- 반도체공학1
- 확률 및 랜덤변수

미래반도체 핵심 마이크로전공 이수가능

- 전자회로2
- 디지털집적회로
- 아날로그집적회로

미래 반도체 마이크로전공 예시 (전자공학과 3학년2학기)

년도/학기	과목명	학점	년도/학기	과목명	학점
<전문교양>			2024-1학기	전자회로실험(설계:1)	2
2020-1학기	영어2	3	2024-2학기	융합캡스톤디자인1(설계:2)	2
2020-2학기	영어1(E)	3	<전공인선>		
2023-1학기	글쓰기	3	2024-1학기	디지털시스템설계(E)	3
2023-동계계절	과학기술과 법	3	2024-1학기	자동제어	3
<수학>			2024-1학기	확률 및 랜덤변수	3
2020-1학기	수학1	3	2024-2학기	디지털집적회로(설계:1)	3
2020-2학기	공업수학A	3	2024-2학기	반도체공학2	3
2020-2학기	수학2	3	2024-2학기	반도체실험(설계:1)	3
2023-1학기	공업수학G	3	2024-2학기	아날로그집적회로(설계:1)	3
<기초과학>			<교양선택>		
2020-1학기	물리학1	3	2020-1학기	아주희망	1
2020-1학기	물리학실험1	1	2023-1학기	아주인성	1
2020-1학기	화학	3	2024-2학기	여대생 커리어개발2	1
2020-1학기	화학실험	1			
2020-2학기	물리학2	3			
2020-2학기	물리학실험2	1			
2023-2학기	현대물리학	3			
<전산학>					
2020-1학기	융합프로그래밍	4			
2023-2학기	전자장론	3			
2023-2학기	전자회로1	3			
2024-1학기	반도체공학1	3			
2024-1학기	전자회로2	3			

미래반도체 기초 마이크로전공 이수가능

- 융합프로그래밍
- 논리회로
- 전자기학
- 회로이론
- 반도체공학1
- 확률 및 랜덤변수

미래반도체 핵심 마이크로전공 이수가능

- 전자회로2
- 디지털집적회로
- 아날로그집적회로

★ 미래반도체 연계전공 이수 가능 ★

****신청만으로도 장학금 수혜 가능****

(총 37학점 이수)

미래 반도체 마이크로전공 예시 (지능형반도체공학과 2학년 1학기)

학수구분	수강번호	교과목명	학점
교필	X340	아주인성	1.0
교필	X363	인공지능이해및활용	3.0
교필	X003	반도체진로탐색	1.0
교필	X295	글쓰기	3.0
교필	X560	물리학1	3.0
교필	X512	물리학실험1	1.0
교필	X458	수학1	3.0
교필	X229	영어1	3.0
교필	C103	공업수학A	3.0
교필	C102	융합프로그래밍	4.0
전필	C099	인공지능기초실습	2.0
전필	C100	반도체공정기초	3.0
교필	X414	물리학2	3.0
교필	X364	물리학실험2	1.0
교필	X292	수학2	3.0
교필	X561	미래산업혁명과 기술창업론	3.0
전필	C106	반도체물리	3.0
전필	C086	기초전기실험	2.0
전필	C080	논리회로	3.0
전필	C002	회로이론	3.0
전필	C028	전자기학	3.0

미래반도체 기초 마이크로전공 이수가능

- 융합프로그래밍
- 인공지능기초실습
- 반도체물리
- 논리회로
- 회로이론
- 전자기학

미래 반도체 마이크로전공 예시 (지능형반도체공학과 2학년 1학기)

학수구분	수강번호	교과목명	학점
교필	X340	아주인성	1.0
교필	X363	인공지능이해및활용	3.0
교필	X003	반도체진로탐색	1.0
교필	X295	글쓰기	3.0
교필	X560	물리학1	3.0
교필	X512	물리학실험1	1.0
교필	X458	수학1	3.0
교필	X229	영어1	3.0
교필	C103	공업수학A	3.0
교필	C102	융합프로그래밍	4.0
전필	C086	기초전기실험	2.0
전필	C080	논리회로	3.0
전필	C002	회로이론	3.0
전필	C028	전자기학	3.0

미래반도체 기초 마이크로전공 이수가능

- 융합프로그래밍
- 인공지능기초실습
- 반도체물리
- 논리회로
- 회로이론
- 전자기학

3학점 더 들으면

★미래반도체 부전공 이수 가능 ★

****장학금 수혜 가능****

(현재 총 18학점 이수)

03

반도체특성화사업단

수혜학생 혜택 및 신청방법

수혜학생 혜택

장학금 지급

- 수혜학생 대상 교과 우수, 전공 이수 등 장학금제도 운영
- 등록금 범위 초과하여 중복수혜 가능
- 최대 1인당 200만원 장학금 지급

(단, 교내 장학기준에 따라 휴학생, 초과학기생, 직전학기 성적 2.0미만 및 12학점 이하 이수자 지급 불가)

미래반도체 연계전공 학위수여

- 연계전공 : 복수전공/부전공에 따라 제1전공 학위증에 '미래반도체 연계전공 복수전공/부전공' 표기
- 마이크로 전공 : 제1전공 학위증에 '미래반도체 OO 마이크로전공 이수' 표기

수혜학생 혜택

현장실습 기회제공

- 반도체 기업 현장실습 우선 선발
- 주요 반도체 기업/연구소와의 MOU를 통해 질적으로 높은 현장실습 기회 확대

글로벌 프로그램 참여

- 해외 연구소 및 산업체 단기 파견
- 해외 유수 대학 및 학회 연계 프로그램 참여

신청 방법

마이크로 전공

-2024년도 2학기 개설 예정(11월)

- 학사서비스 신청 (타 과 마이크로전공 신청방법과 동일)

포털사이트 →학사서비스→ 학적 → 전공변경 신청
→ 구분 : 미래반도체 OO마이크로 전공 선택

연계 전공

-2025년도 1학기 개설 예정

- 마이크로전공 신청자에 한하여 사업단에서 자체 수요조사 예정

2학기 마이크로 전공 신청자들에게 구글폼을 통해 수요조사
수요조사 후 2025년 1학기 본인신청 필요

THANK YOU

반도체특성화사업단

Copyright © Mangoboard All Rights Reserved.